

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及 重组上市的说明

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州众硅电子科技有限公司（以下简称“标的公司”）的股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

一、本次交易预计不构成重大资产重组

本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定。经初步预估，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）规定的重大资产重组标准。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在交易报告书中予以详细分析和披露。

二、本次交易预计不构成关联交易

本次交易的交易对方在本次交易前与上市公司之间不存在关联关系。经初步测算，本次交易后预计无交易对方持有公司股份超过 5%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次交易预计不构成关联交易。

三、本次交易不构成重组上市

本次交易前 36 个月内，上市公司实际控制人未发生变更。本次交易前后，上市公司均不存在控股股东和实际控制人，本次交易不会导致上市公司控制权变更。根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。

特此说明。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日